



目录

特性参数.....	2
亮度分档.....	2
显指分档.....	2
电压分档.....	2
色区分档.....	3
光电性能特征曲线.....	4
出货编码规则.....	5
产品尺寸.....	6
回流焊曲线.....	7
注意事项.....	8

产品特征

规格: 3.7mm×1.5mm
倒装结构陶瓷封装
典型光通量 (25℃)
350mA: 250lm

应用

城市亮化
商业照明
汽车照明

特性参数 (IF=350mA, T_{Solder pad} =25°C)

项目	单位	最小值	典型值	最大值
发光角度	degrees (°)	--	120	--
正向电流	mA	--	350	700
正向电压	V	5.8	6.0	6.2
反向电压	V	--	--	5
LED 结温	°C	--	--	150

亮度分档 (IF=350mA, T_{Solder pad} =25°C)

级别	亮度范围(lm)
T3	220 ~ 240
T4	240 ~ 260
T5	260 ~ 280

备注：亮度测试误差±7%

显指分档 (IF=350mA, T_{Solder pad} =25°C)

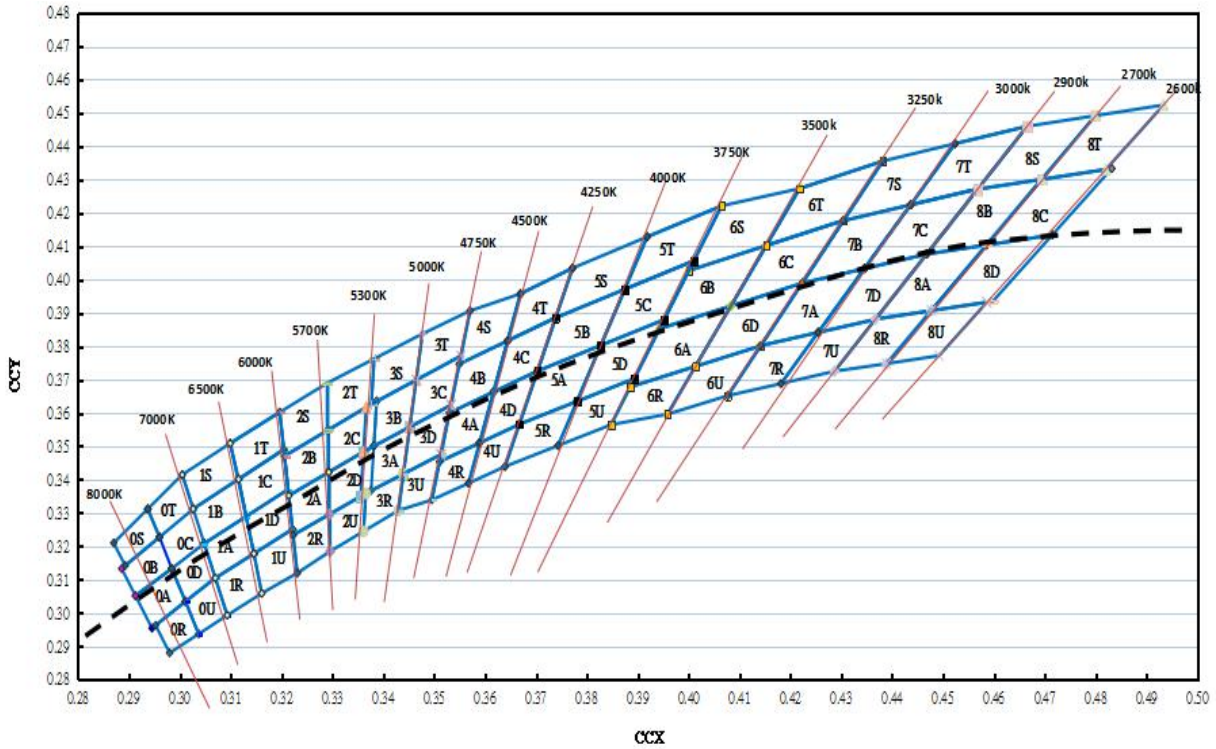
级别	亮度范围(lm)
B0	70 ~ 100

电压分档 (IF=350mA, T_{Solder pad} =25°C)

级别	亮度范围(lm)
VT	5.8 ~ 6.1
VW	6.1 ~ 6.4
VX	6.4 ~ 6.7

备注：电压测试误差±1%

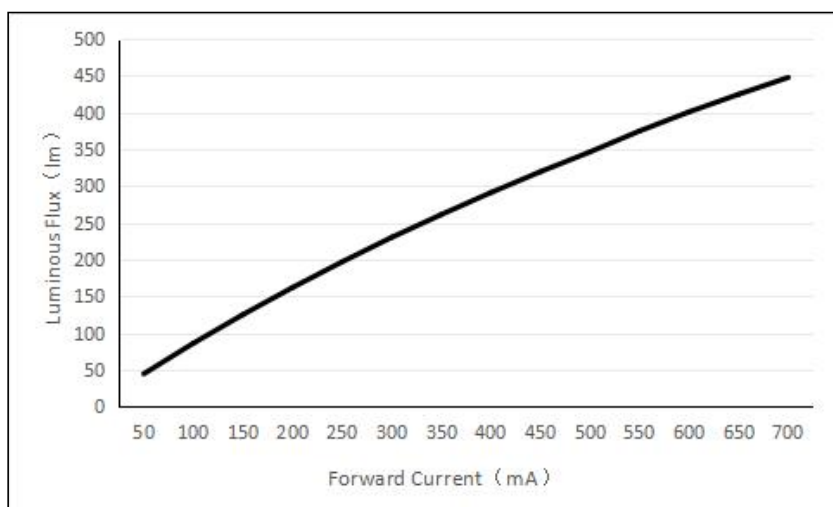
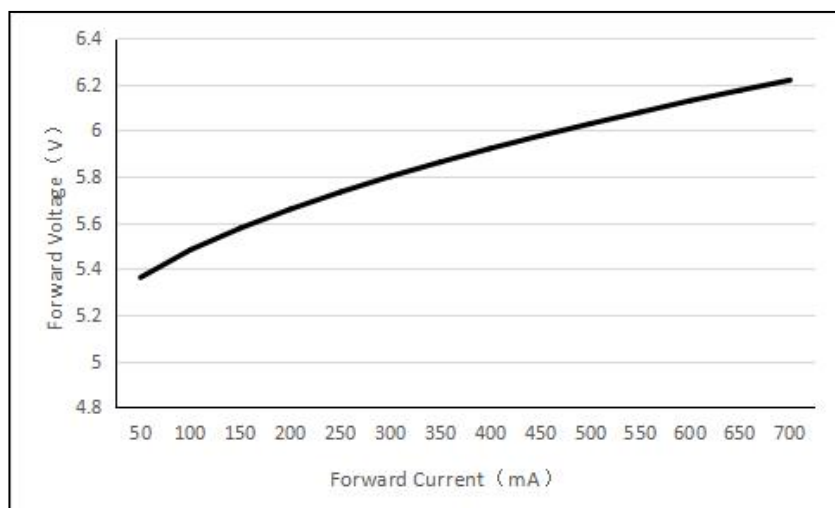
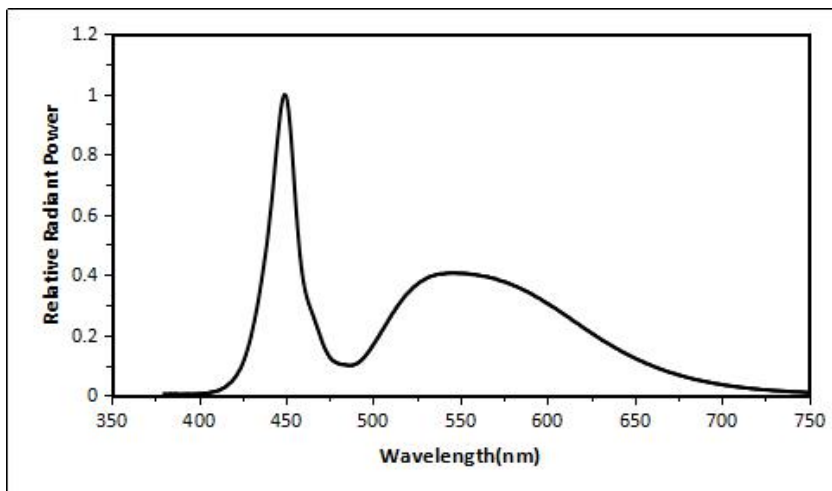
色区分档 (IF=350mA, T_{Solder pad}=25°C)

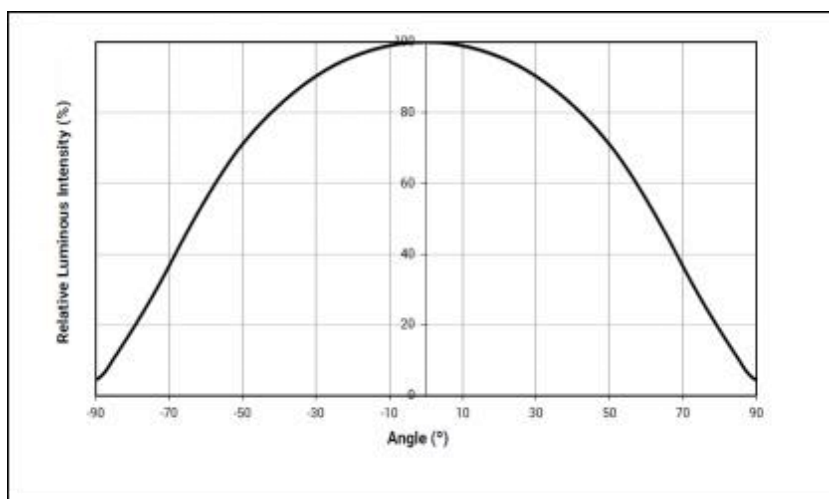
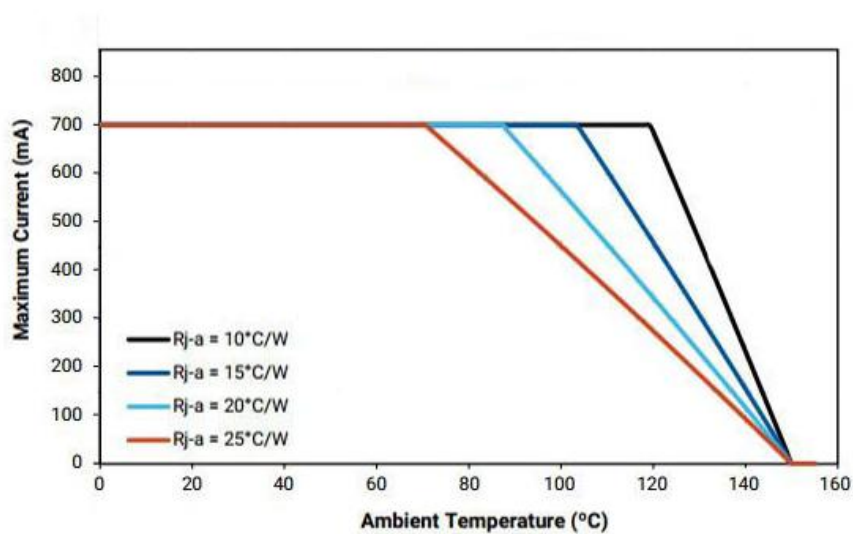


色度 & 色温对照表	
典型色温 (K)	色度区域
5000~5300	3S、3B、3A、3R
5300~5700	2T、2C、2D、2U
5700~6000	2S、2B、2A、2R
6000~6500	1T、1C、1D、1U
6500~7000	1S、1B、1A、1R

备注：色坐标 (Cx, Cy) 误差范围±0.005

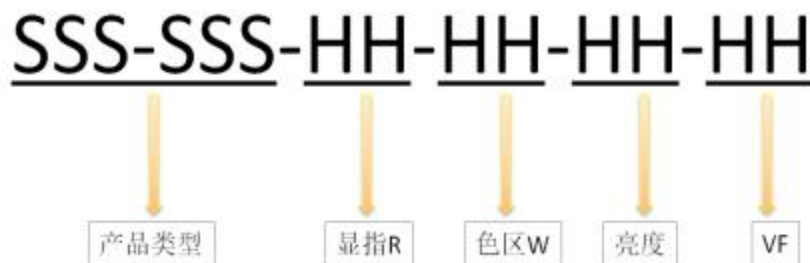
光电性能特征曲线 (IF=350mA, T_{Solder pad} =25°C)





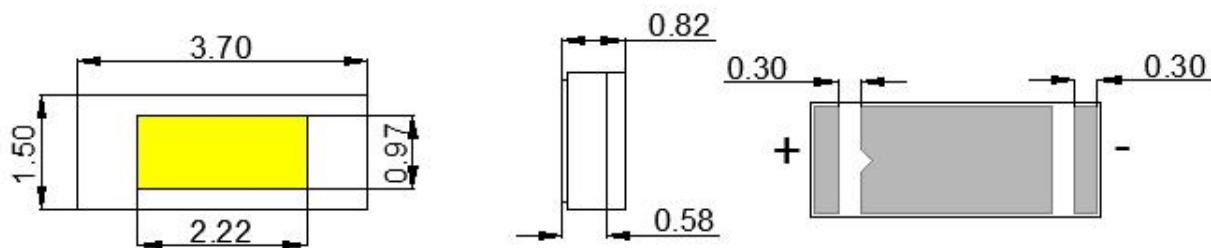
出货条码规则

下图为产品编码规则



例如：1537AWT-B0-1D-T4-VW，其中 B0 表示显指，对应范围 70 ~ 100；1D 表示色温，对应范围 6000K~6500K；T4 表示亮度，对应范围 240 ~ 260 lm；VW 表示正向电压，对应范围 6.1 ~ 6.4 V。

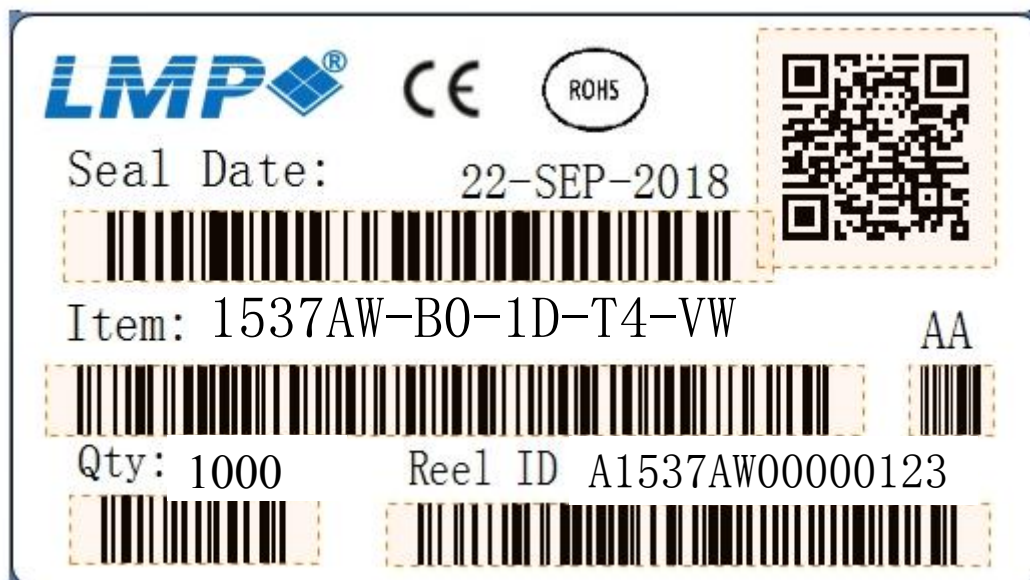
产品尺寸



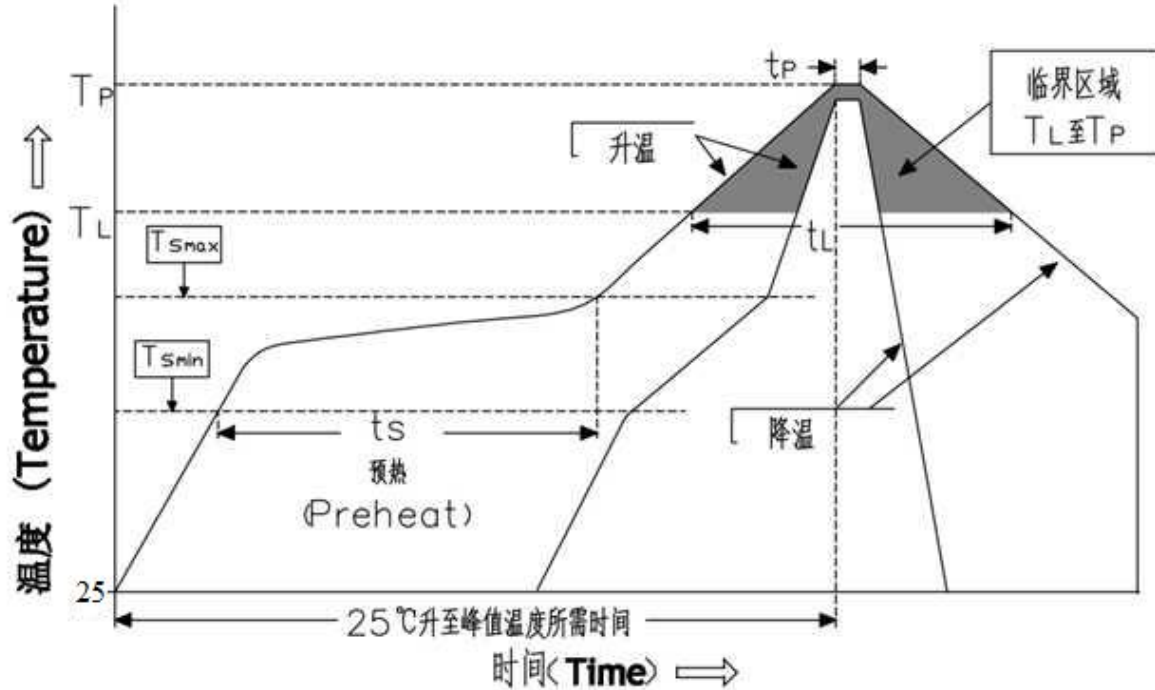
单位: mm.

误差: ± 0.05

出货条码



回流焊升温曲线



分布特征	含铅回流焊	无铅回流焊
平均升温速度 ($T_{Smax}-T_p$)	3°C/second max.	3°C/second max.
最低预热温度 (T_{Smin})	100°C	150°C
最高预热温度 (T_{Smax})	150°C	200°C
预热时间 ($t_{Smin}-t_{Smax}$)	60~120 seconds	60~180 seconds
温度 (T_L)	183°C	217°C
维持在 T_L 以上的时间 (t_L)	60~150 seconds	60~150 seconds
峰值温度 (T_p)	215°C	260°C
维持与实际峰值温度相差在 5°C 以内的时间 (t_p)	10~30 seconds	20~40 seconds
降温速度	6°C/second max.	6°C/second max.
从 25°C 升至峰值温度所需时间	6 minutes max.	8 minutes max.

备注:

1. 所有温度指封装表面温度，为封装体表面测定的数据；
2. 本回流焊曲线提供参考，并非适用于所有的 PCB 设计和回流焊设备；
3. 其他事项请参考《使用注意事项》。

使用注意事项

一、储存

1. 储存温度 5~30℃,相对湿度小于 28%。
2. 避免外力破坏真空包装袋,以防受潮。

二、使用

1. 正品锡膏,标准自动贴片机贴装。
2. 八温区以上回流焊,峰值温度小于 260℃,时间小于 10s。
3. 重复回流焊不超过 2 次。
4. 杜绝对灯珠施力受压,以免透镜刮伤、变形或脱落,造成死灯。
- 5 禁止使用有机溶剂或超声波。
- 6.焊接面空洞率小于 20%。
- 7.冷却后方能测试及使用。
- 8.做好静电防护。